



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 面向芯粒集成的铜/二氧化硅混合键合技术研究

演讲人: 方君鹏 清华大学集成电路学院

演讲摘要:

演讲大纲:

适合对象:

演讲人简介:

毕业于清华大学集成电路学院，工学博士学位。从事先进封装与系统集成方向的研究，主要研究内容包括混合键合工艺研究、纳米互连与芯粒(Chiplet)集成工艺研究、以及互连可靠性与失效机理分析等。目前在 Applied Surface Science、IEEE EDL、IEEE TED、ECTC 等国内外重要学术期刊和高水平国际会议上发表多篇文章。